

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2004年11月11日 (11,11,2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/097780 A1

(51) 国際特許分類7: G09G 3/28, H01G 4/12, H01L 25/07

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/006072

(22) 国際出願日:

2004年4月27日(27.04.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

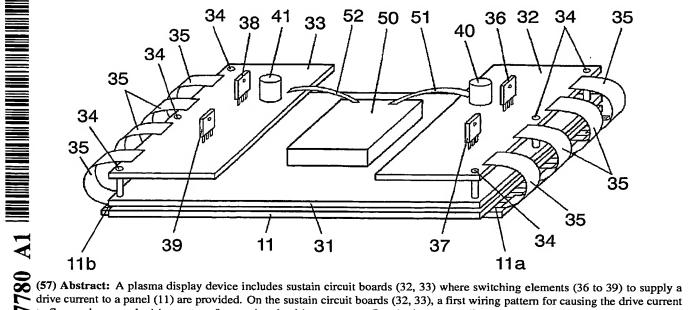
(30) 優先権データ: 特願2003-124200 2003年4月28日(28.04.2003) JI

- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5718501 大阪府門真市大字門真1006番地 Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 中谷 敏邦 (NAKATANI, Toshikuni). 伊藤 幸治 (ITO, Yukiharu).

- (74) 代理人: 岩橋 文雄, 外(IWAHASHI, Fumio et al.); 〒 5718501 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 松下電器産業株式会社内 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,

/続葉有/

- (54) Title: PLASMA DISPLAY DEVICE
- (54) 発明の名称: プラズマディスプレイ装置



(57) Abstract: A plasma display device includes sustain circuit boards (32, 33) where switching elements (36 to 39) to supply a drive current to a panel (11) are provided. On the sustain circuit boards (32, 33), a first wiring pattern for causing the drive current to flow and a second wiring pattern for causing the drive current to flow in the reverse direction to the direction in which the drive current flows in the first wiring pattern are so formed as to face each other. Such a structure reduces in the parasitic inductance, resulting in reduced ringing of the panel voltage waveform.

(57) 要約: パネル (11) に駆動電流を供給するスイッチング素子 (36) ~スイッチング素子 (39) を備えた サステイン回路基板 (32) 、 (33) を有し、前記サステイン回路基板 (32) 、 (33) に、前記駆動電流を 流すための第1の配線パターンと、この第1の配線パターンに対向するように形成されかつ前記第1の配線パターンに流れる方向とは逆方向に前記駆動電流を流す第2の配線パターンとを配設する。このような構成により、寄生 インダクタンスが低減され、パネルの電圧波形のリンギングが低減されたプラズマディスプレイ装置を提供する。

7O 2004/097780 A1

WO \$34/097780 A1

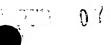


IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

一 国際調査報告書



0 1 JEC 2004



1 .

明細書

プラズマディスプレイ装置

5 技術分野

本発明は、テレビジョン受像機およびコンピュータ端末等の画像表示に用いられるプラズマディスプレイ装置に関する。

背景技術

15

20

25

10 近年、プラズマディスプレイ装置は、視認性に優れた表示パネル(薄型表示デバイス)として注目されており、高精細化および大画面化が進められている。

このプラズマディスプレイ装置には、大別して、駆動的にはAC型とDC型があり、放電形式では面放電型と対向放電型の2種類ある。高精細化、大画面化および製造の簡便性から、現状では、AC型で面放電型のプラズマディスプレイ装置が主流を占めるようになってきている。

このようなプラズマディスプレイ装置においては、透明な一対のガラス基板を対向配置し、これらのガラス基板間に放電空間が形成されるようにする。また、このガラス基板に電極群を配置したプラズマディスプレイパネル(以下パネルという)と、このパネルを保持するシャーシ部材と、このシャーシ部材に取り付けられパネルに信号を印加して表示を行う表示駆動回路ブロックとでパネルモジュールを構成する。そして、このパネルモジュールを筐体で覆うことにより完成品としている。

まず、プラズマディスプレイ装置における表示パネルの構造について、図8を 用いて説明する。図8に示すように、ガラス基板などの透明な前面側の基板1上 には、走査電極と維持電極とで対をなすストライプ状の表示電極2が複数列形成 される。さらに、その電極群を覆うように誘電体層3が形成され、その誘電体層 3上には保護膜4が形成されている。

また、前面側の基板1に対向配置される背面側の基板5上には、走査電極及び 維持電極の表示電極2と交差するように、オーバーコート層6で覆われた複数列

25

のストライプ状のアドレス電極7が形成されている。このアドレス電極7間のオーバーコート層6上には、アドレス電極7と平行に複数の隔壁8が配置され、この隔壁8間の側面およびオーバーコート層6の表面に蛍光体層9が設けられている。

5 これらの基板1と基板5とは、走査電極および維持電極の表示電極2とアドレス電極7とがほぼ直交するように、微小な放電空間を挟んで対向配置されるとともに、周囲が封止される。放電空間には、ヘリウム、ネオン、アルゴン、キセノンのうちの一種または混合ガスが放電ガスとして封入されている。また、放電空間は、隔壁8によって複数の区画に仕切ることにより、表示電極2とアドレス電10 極7との交点が位置する複数の放電セルが設けられ、その各放電セルには、赤色、緑色及び青色となるように蛍光体層9が一色ずつ順次配置されている。

図9にこのパネルの電極配列を示す。図9に示すように走査電極および維持電極とアドレス電極とは、M行×N列のマトリックス構成である。行方向にはM行の走査電極SCN1~SCNMおよび維持電極SUS1~SUSMが配列され、列方向にはN列のアドレス電極D1。DNが配列されている

15 列方向にはN列のアドレス電極D1~DNが配列されている。

このような電極構成のパネルにおいては、アドレス電極と走査電極の間に書き 込みパルスが印加されることにより、アドレス電極と走査電極の間でアドレス放 電が行なわれ、放電セルが選択される。そして、走査電極と維持電極との間に、 交互に反転する周期的な維持パルスが印加されることにより、走査電極と維持電 極との間で維持放電が行なわれ、所定の表示がなされる。

図10は、このようなパネルを用いたプラズマディスプレイ装置において、主要回路基板の配置構造を示している。また、図12は、このプラズマディスプレイ装置の電気的等価回路を示す回路図である。図10に示すように、パネル11は、機械的強度を高めるため、支持基板12に接着されている。そして、図12に示されたパネル11の一方の走査電極群11aには、フレキシブル接続基板13を介してサステイン回路基板14が接続され、他方の維持電極群11bにはフレキシブル接続基板13を介してサステイン回路基板15が接続されている。

サステイン回路基板14にはパネル11を駆動するためのスイッチング素子16、17およびパルス電流供給源としての平滑コンデンサ18が実装されている。

10

また前記サステイン回路基板 15 にはパネル 11 を駆動するためのスイッチング素子 19、 20 およびパルス電流供給源としての平滑コンデンサ 21 が実装されている。

また、サステイン回路基板14、15は、それぞれ導電性支持具22を介して 導電性基板23に機械的に取り付けられると共に、電気的に接続されている。さ らに、サステイン回路基板14、15は、電源回路24に配線部材25、26を 介して接続されており、その電源回路24からサステイン回路基板14、15に 電圧が供給される。

このプラズマディスプレイ装置においては、サステイン回路基板14とサステイン回路基板15から交互にサステインパルスが出力され、図11に示すように 走査電極群と維持電極群にサステインパルスが印加されて、パネル11に駆動電 流が供給される。

なお、上述した技術は、特許第2807672号公報に記載されている。

ところで、上記従来のプラズマディスプレイ装置においては、図12に示すよ うな経路で駆動電流が流れる。期間 t 1 は、走査電極群11 a にサステインパル スを印加する期間である。駆動電流は、平滑コンデンサ18のプラス側電極から スイッチング素子16を経てパネル11に流れ込む。さらに、この駆動電流はパ ネル11からスイッチング素子20を経て、導電性基板23を通り、もとの平滑 コンデンサ18のマイナス側電極に入ってもどる。

20 期間 t 2 は、維持電極群 1 1 b にサステインパルスを印加する期間である。駆動電流は、平滑コンデンサ 2 1 のプラス側電極からスイッチング素子 1 9 を経てパネル 1 1 に流れ込む。さらに、この駆動電流はパネル 1 1 からスイッチング素子 1 7 を経て、導電性基板 2 3 を通り、もとの平滑コンデンサ 2 1 のマイナス側電極に入ってもどる。なお、図 1 2 において、容量性成分 C がパネル 1 1 の各放電セルに存在し、寄生インダクタンス L 1 ~ L 1 5 が、各部に存在する。

しかし、図12に示すように、パネル11とサステイン回路基板14、15、 導電性基板23から構成される電流経路には、寄生インダクタンスL1~L15 が存在する。よって、パネル11のサステイン動作において、di/dtの大き い駆動電流が流れると、図11に示すように駆動電流が流れる瞬間に、パネル1



1の電極群に印加される電圧波形に大きなリンギングが生じる。このため、パネル11に印加される電圧が下がり、パネル11の動作電圧マージンが狭くなるという課題があった。

5 発明の開示

本発明は、プラズマディスプレイ装置の寄生インダクタンスを低減して、パネルの電圧波形のリンギングを低減するものである。

本発明のプラズマディスプレイ装置は、パネルに駆動電流を供給するスイッチング素子を備えた回路基板を有し、この回路基板に、駆動電流を流すための第1 の配線パターンと、この第1の配線パターンに対向するように形成されかつ第1 の配線パターンに流れる方向とは逆方向に駆動電流を流す第2の配線パターンとを配設したことを特徴とする。

図面の簡単な説明

15 図1は本発明の一実施の形態によるプラズマディスプレイ装置の要部構造を示す斜視図である。

図2は本発明のプラズマディスプレイ装置のサステイン回路基板に形成する配線パターンを示す平面図である。

図3は本発明のプラズマディスプレイ装置の別のサステイン回路基板に形成す 20 る配線パターンを示す平面図である。

図4は本発明のプラズマディスプレイ装置の駆動波形図である。

図5は本発明のプラズマディスプレイ装置の電気的等価回路を示す回路図である。

図 6 は本発明の他の実施の形態によるプラズマディスプレイ装置の要部構造を 25 示す斜視図である。

図7は本発明の他の実施の形態によるプラズマディスプレイ装置の電気的等価回路を示す回路図である。

図8は従来のプラズマディスプレイパネルを示す斜視図である。

図9は従来の電気配線図である。

- 図10は従来のプラズマディスプレイ装置を示す斜視図である。
- 図11は従来のプラズマディスプレイ装置の駆動波形図である。
- 図12は従来のプラズマディスプレイ装置の電気的等価回路を示す回路図である。

25

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明の一実施の形態によるプラズマディスプレイ装置について、図1 ~図7の図面を参照しながら説明する。

図1は本発明の一実施の形態によるプラズマディスプレイ装置において、回路 10 基板の配置構造を示す図である。

パネル11は、導電性基板であるアルミニウムなどからなるシャーシ部材31 に熱伝導性部材を介して接着することにより保持されている。

サステイン回路基板32、33は、シャーシ部材31にビスなどの導電性支持 具34により取り付けられ、パネル11の走査電極群11a、維持電極群11b に配線基板としての複数のフレキシブル接続基板35を介して接続されている。 また、このサステイン回路基板32、33には、それぞれパネル11を駆動する ためのMOSFETなどからなるスイッチング素子36~39と、パルス電流供 給源としてのコンデンサである平滑コンデンサ40、41が実装されて配設され ている。

20 図 2 は本発明のプラズマディスプレイ装置のサステイン回路基板に形成する配線パターンを示す平面図である。

サステイン回路基板32は、図2Aに示すように、スイッチング素子36、37や平滑コンデンサ40の実装面側に、パネル11の電極に接続したフレキシブル接続基板35が接続される第1の配線パターン42を形成する。また、図2Bに示すように、反対の裏面側に、この第1の配線パターン42に対向するように第2の配線パターン43を形成している。さらに、図2Aでは実装面側に平滑コンデンサ40とスイッチング素子36とを接続する第3の配線パターン44を形成し、図2Bに示す反対の裏面側には、この第3の配線パターン44に対向する

25

20

ように第2の配線パターン43と一体に第4の配線パターン45を形成している。また、サステイン回路基板32の配線パターン43は、サステイン回路基板32をシャーシ部材31に取り付けるビスにより、シャーシ部材31に接地されている。

5 図3は本発明のプラズマディスプレイ装置の別のサステイン回路基板に形成する配線パターンを示す平面図である。

サステイン回路基板33は、図3Aに示すように、スイッチング素子38、39や平滑コンデンサ41の実装面側に、前記パネル11の電極に接続したフレキシブル接続基板35が接続される第1の配線パターン46を形成する。また、図3Bに示すように、反対の裏面側に、この第1の配線パターン46に対向するように第2の配線パターン47を形成している。さらに、図3Aでは実装面側に平滑コンデンサ41とスイッチング素子38とを接続する第3の配線パターン48を形成し、図3Bに示す反対の裏面側には、この第3の配線パターン48に対向するように第2の配線パターン47と一体に第4の配線パターン49を形成している。また、サステイン回路基板33の配線パターン47は、サステイン回路基板33をシャーシ部材31に取り付けるビスにより、シャーシ部材31に接地されている。

図1に示す電源回路50は、サステイン回路基板32、33に電圧を供給し、配線部材51、52を介して前記サステイン回路基板32、33に接続されている。

図4は本発明のプラズマディスプレイ装置の駆動波形図である。

このようなプラズマディスプレイ装置において、図4に示すように、サステイン回路基板32とサステイン回路基板33から交互にサステインパルスが出力され、走査電極群と維持電極群にサステインパルスが印加され、パネル11に駆動電流が供給される。この駆動電流はパルス状波形であり、大きなdi/dtを持つ。42インチサイズのパネルを例にすると、駆動電流のdi/dtは109A/s程度まで達する。

図5は本発明のプラズマディスプレイ装置の電気的等価回路を示す回路図である。本実施の形態によるプラズマディスプレイ装置の駆動電流の経路について図

5を用いて説明する。

期間t1は、走査電極群11aにサステインパルスを印加する期間である。プ ラズマディスプレイ装置の駆動電流は、平滑コンデンサ40のプラス側電極から 寄生インダクタンスL44を有するサステイン回路基板32の配線パターン44 上を通り、スイッチング素子36へ入る。さらに、駆動電流は、スイッチング素 子36から寄生インダクタンスL42を有するサステイン回路基板32の配線パ ターン42上を通り、寄生インダクタンスL35を有するフレキシブル接続基板 35を経て、電極群の寄生インダクタンスL11及びセル群の容量性成分Cを有 するパネル11に流れ込む。次に、この駆動電流は、パネル11から寄生インダ 10 クタンスL35を有するフレキシブル接続基板35を経て、寄生インダクタンス L46を有するサステイン回路基板33の配線パターン46上を通り、スイッチ ング素子39に入る。さらに、この駆動電流は、スイッチング素子39から寄生 インダクタンスL47を有するサステイン回路基板33の配線パターン47上を 通り、寄生インダクタンスL34を有するビスなどの導電性支持具34を介して 寄生インダクタンスL31を有するシャーシ部材31へ流れ込む。次に、この駆 15 動電流は、シャーシ部材31から寄生インダクタンスL34を有する導電性支持 具34を経て、寄生インダクタンスL43を有するサステイン回路基板32の配 線パターン43上を通り、最後に寄生インダクタンスL45を有するサステイン 回路基板32の配線パターン45上を通って、もとの平滑コンデンサ40のマイ 20 ナス側電極へもどる。このような多数の寄生インダクタンスが存在している経路 を通り、プラズマ装置の駆動電流は一巡する。

ここで、サステイン回路基板32には、図2に示すように、部品実装面に平滑 コンデンサ40からスイッチング素子36までの配線パターン44と、スイッチ ング素子36からフレキシブル接続基板35までの配線パターン42とが形成さ れ、反対側のはんだ面に前記配線パターン42、44に対向する個所に導電性支 持具34から平滑コンデンサ40までの配線パターン43、45が形成されてい る。また、フレキシブル接続基板35を介してパネル11を接続する個所と、導 電性支持具34を介してシャーシ部材31を接続する個所とがサステイン回路基 板32の同じ端部に形成されている。

15

この構成により配線パターン44の寄生インダクタンスL44と、配線パターン45の寄生インダクタンスL45に互いに逆方向の駆動電流I1、I2が近接して流れ、負の相互インダクタンスを形成するので、寄生インダクタンスL44とL45は等価的に小さくなる。また、配線パターン42の寄生インダクタンスL43にも互いに逆方向の駆動電流I1、I2が近接して流れ、負の相互インダクタンスを形成するので、寄生インダクタンスL42とL43は等価的に小さくなる。

また、サステイン回路基板33には、図3に示すように、部品実装面に平滑コンデンサ41からスイッチング素子38までの配線パターン48と、スイッチング素子38からフレキシブル接続基板35までの配線パターン46とが形成される。反対側のはんだ面に前記配線パターン46、48に対向する個所に導電性支持具34から平滑コンデンサ41までの配線パターン47、49が形成されている。また、フレキシブル接続基板35を介してパネル11を接続する個所と、導電性支持具34を介してシャーシ部材31を接続する個所とがサステイン回路基板33の同じ端部に形成されている。

この構成により配線パターン46の寄生インダクタンスL46と、配線パターン47の寄生インダクタンスL47に互いに逆方向の駆動電流I3、I4が近接して流れ、負の相互インダクタンスを形成するので、寄生インダクタンスL46とL47は等価的に小さくなる。

20 同様に、期間 t 2 は、維持電極群 1 1 b にサステインパルスを印加する期間である。プラズマ装置の駆動電流は、平滑コンデンサ 4 1 のプラス側電極から寄生インダクタンス L 4 8 を有するサステイン回路基板 3 3 の配線パターン 4 8 上を通り、スイッチング素子 3 8 へ入る。さらに、駆動電流は、スイッチング素子 3 8 から寄生インダクタンス L 4 6 を有するサステイン回路基板 3 3 の配線パター 25 ン4 6 上を通り、寄生インダクタンス L 3 5 を有するフレキシブル接続基板 3 5 を経て、電極群の寄生インダクタンス L 1 1 及びセル群の容量性成分 C を有するパネル 1 1 に流れ込む。次に、この駆動電流は、パネル 1 1 から寄生インダクタンス L 4 2 を有するサステイン回路基板 3 2 の配線パターン 4 2 上を通り、スイッチング

15

素子37に入る。さらに、この駆動電流は、スイッチング素子37から寄生インダクタンスL43を有するサステイン回路基板32の配線パターン43上を通り、寄生インダクタンスL34を有するビスなどの導電性支持具34を介して寄生インダクタンスL31を有するシャーシ部材31へ流れ込む。次に、この駆動電流は、シャーシ部材31から寄生インダクタンスL34を有する導電性支持具34を経て、寄生インダクタンスL47を有するサステイン回路基板33の配線パターン47上を通り、最後に寄生インダクタンスL49を有するサステイン回路基板33の配線パターン49上を通って、もとの平滑コンデンサ41のマイナス側電極へもどる。

10 この駆動電流経路にも多数の寄生インダクタンスが存在しているが、ここでも 上述のように寄生インダクタンスによる影響を減少させることができる。

すなわち、サステイン回路基板33の部品面には、平滑コンデンサ41からスイッチング素子38までの配線パターン48とスイッチング素子38からフレキシブル接続基板35までの配線パターン46が形成されている。また、はんだ面には前記配線パターン46、48に対向する個所に導電性支持具34から平滑コンデンサ41までの配線パターン47、49が形成されている。そして、フレキシブル接続基板35を介してパネル11を接続する個所と導電性支持具34を介してシャーシ部材31を接続する個所が、サステイン回路基板33の同じ端部に形成されている。

20 これにより、配線パターン48の寄生インダクタンスL48と配線パターン49の寄生インダクタンスL49に、互いに逆方向の駆動電流I3、I4が近接して流れ、負の相互インダクタンスを形成するので、寄生インダクタンスL48とL49は等価的に小さくなる。また、配線パターン46の寄生インダクタンスL46と配線パターン47の寄生インダクタンスL47にも、互いに逆方向の駆動電流I3、I4が近接して流れ、負の相互インダクタンスを形成するので、寄生インダクタンスL46とL47は等価的に小さくなる。

また、サステイン回路基板32の部品実装面には、フレキシブル接続基板35 からスイッチング素子37までの配線パターン42が形成されている。また、は んだ面には前記配線パターン42に対向する個所にスイッチング素子37から導

電性支持具34までの配線パターン43が形成されている。そして、フレキシブル接続基板35を介してパネル11を接続する個所と導電性支持具34を介してシャーシ部材31に接続する個所が、サステイン回路基板32の同じ端部に形成されている。

5 これにより、図2に示すように、配線パターン42の寄生インダクタンスL42と配線パターン43の寄生インダクタンスL43に、互いに逆方向の駆動電流 I5、I6が近接して流れ、負の相互インダクタンスを形成するので、寄生イン ダクタンスL42とL43は等価的に小さくなる。したがって、サステイン回路 基板32、33の寄生インダクタンスは著しく減少する。

10 なお、サステイン回路基板 3 3 では、配線パターン 4 6 の寄生インダクタンス L 4 6 と配線パターン 4 7 の寄生インダクタンス L 4 7 には、互いに逆方向で流 れる駆動電流 I 7、 I 8 が近接して流れ、負の相互インダクタンスを形成するの で、寄生インダクタンス L 4 6 と L 4 7 は等価的に小さくなる。

さらに、図5において、パネル11の内部の維持電極群に近接してシャーシ部 材31が設けられている。図4に示すt1,t2の各期間において、パネル11 の電極群の寄生インダクタンスL11とシャーシ部材31の寄生インダクタンス L31に、互いに逆方向の駆動電流が近接して流れ、負の相互インダクタンスを 形成するので、寄生インダクタンスL11とL31は等価的に小さくなる。した がって、パネル11の電極群の寄生インダクタンスL11およびシャーシ部材3 1の寄生インダクタンスL31は著しく減少する。

以上説明したように、寄生インダクタンスL44とL45、L42とL43、 L48とL49、L46とL47、L11とL31はそれぞれ互いに負の相互インダクタンスを形成し、駆動電流経路の寄生インダクタンスは著しく減少する。 したがってdi/dtの大きい駆動電流が流れても、パネル11の電極群に印加される電圧波形のリンギングを小さく抑えることができる。

具体的な例を説明すると、42インチサイズのパネルの場合、従来の装置では リンギングが約50Vあった。しかし、本発明において、回路基板に1.6mm の絶縁層厚みをもつ両面基板を用い、パネルの内部に付設された電極群とシャー シ部材との間隔を5mmとした場合、走査電極群及び維持電極群の電圧に生じる

15

リンギングは、約20Vにまで低減される。

なお、図2、図3の例では、回路基板の表裏に形成される配線パターンを、ほぼ同じ形状で形成して対向させた場合を示した。しかし、配線パターンの形状はこれに限ったものではなく、異なった形状の配線パターンの一部分が対向していてもよい。

例えば、配線パターン43や47が半田面全面を覆う形状をしている場合、配線パターン43、47を流れる駆動電流は、部品面の配線パターン42、44または配線パターン46、48と対向している部分を流れるので、本実施の形態と同様の効果が得られる。なお、これらの配線パターンは、負の相互インダクタンスを形成して電流経路のインピーダンスが最も低くなっている。

また、本実施の形態では、導電性支持具を回路基板のフレキシブル接続基板のある端部にだけ設けた場合を示したが、同時に回路基板のフレキシブル接続基板から遠い端部にも導電性支持具を設けても良い。このような場合にも回路基板と導電性基板との間を流れる駆動電流の大部分は、回路基板の配線パターン間およびパネルとシャーシ部材との間において負の相互インダクタンスを形成しやすい経路を流れる。すなわち、駆動電流はフレキシブル接続基板のある端部に設けた導電性支持具へと流れるので、本実施の形態と同様の効果が得られる。

図6、図7に本発明の他の実施の形態によるプラズマディスプレイ装置を示している。この図6、図7に示す実施の形態においては、2層構造の配線パターン20 を有するフレキシブル接続基板53を用いている。フレキシブル接続基板53に設けた一方の配線パターン54は、パネル11の電極とサステイン回路基板32、33の配線パターン42、46とを接続している。また、他方の配線パターン55は、サステイン回路基板32、33の配線パターン43、47をシャーシ部材31に接地するものである。

25 この構成により、図7に示すように、フレキシブル接続基板53の1層目の配線パターン54と2層目の配線パターン55に逆方向の駆動電流が流れ、負の相互インダクタンスを形成する。よって、フレキシブル接続基板53の1層目の寄生インダクタンスL54と2層目の寄生インダクタンスL55は等価的に小さくなり、パネル11の電極群に印加される電圧波形のリンギングをさらに小さく抑

えることができる。42インチサイズのパネルで実験した結果によれば、本実施の形態の構成とすることにより、走査電極群及び維持電極群の電圧に生じるリンギングが約15Vにまで低減される。

5 産業上の利用可能性

以上のように、本発明によれば、回路基板の寄生インダクタンスが小さくなりパネルに印加される電圧波形のリンギングが低減され、パネルの動作電圧マージンが改善される。よって、本発明のプラズマディスプレイ装置は、テレビジョン受像機およびコンピュータ端末等の画像表示に用いられる。

請求の範囲

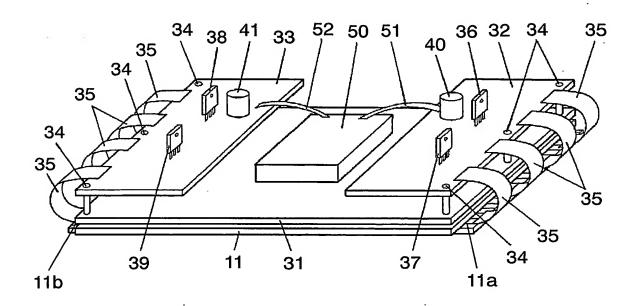
- 1. プラズマディスプレイパネルに駆動電流を供給するスイッチング素子を備えた回路基板を有し、前記回路基板に、前記駆動電流を流すための第1の配線パターンと、この第1の配線パターンに対向するように形成されかつ前記第1の配線パターンに流れる方向とは逆方向に前記駆動電流を流す第2の配線パターンとを配設したことを特徴とするプラズマディスプレイ装置。
- プラズマディスプレイパネルを保持する導電性基板と、この導電性基板に接地されかつ前記プラズマディスプレイパネルに駆動電流を供給するスイッチング素子を備えた回路基板とを有し、前記回路基板に、前記プラズマディスプレイパネルとスイッチング素子とを接続する第1の配線パターンと、この第1の配線パターンに対向するように形成されかつ前記導電性基板とスイッチング素子とを接続すると共に前記第1の配線パターンに流れる方向とは逆方向に前記駆動電流を流す第2の配線パターンとを配設したことを特徴とするプラズマディスプレイ装置。
- 3. プラズマディスプレイパネルを保持する導電性基板と、この導電性基板に 取り付けられかつ前記プラズマディスプレイパネルに駆動電流を供給するスイッチング素子を備えた回路基板と、この回路基板と前記パネルの電極とを接続する複数の配線基板とを有し、前記回路基板に、前記プラズマディスプレイパネルとスイッチング素子とを接続する第1の配線パターンと、この第1の配線パターンに対向するように形成されかつ前記導電性基板とスイッチング素子とを接続すると共に前記第1の配線パターンに流れる方向とは逆方向に前記駆動電流を流す第2の配線パターンとを配設し、かつ前記配線基板に前記回路基板を導電性基板に接地するための配線パターンを配設したことを特徴とするプラズマディスプレイ装置。

10

 $\delta = \delta^{-1}$

- 4. 回路基板にスイッチング素子に接続されるコンデンサを設け、かつ前記回路基板に、前記コンデンサとスイッチング素子とを接続する第3の配線パターンと、この第3の配線パターンに対向するように形成されかつ前記導電性基板とコンデンサとを接続すると共に前記第3の配線パターンに流れる方向とは逆方向に前記駆動電流を流す第4の配線パターンとを配設した請求項2または3に記載のプラズマディスプレイ装置。
- 5. プラズマディスプレイパネルに流れる駆動電流と導電性基板に流れる駆動電流の向きが逆方向となるように構成したことを特徴とする請求項2 または3に記載のプラズマディスプレイ装置。

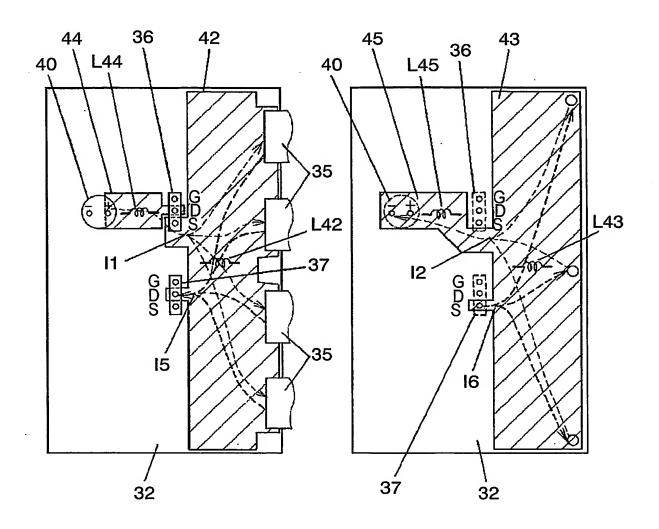
1/11 FIG. 1



2/11

FIG. 2A

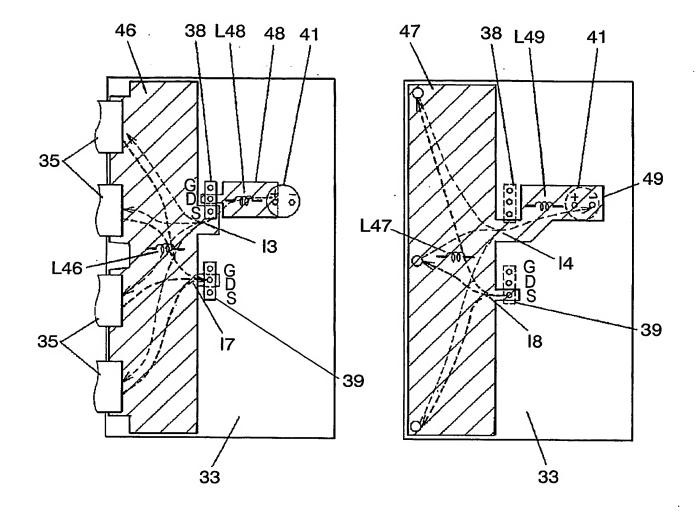
FIG. 2B



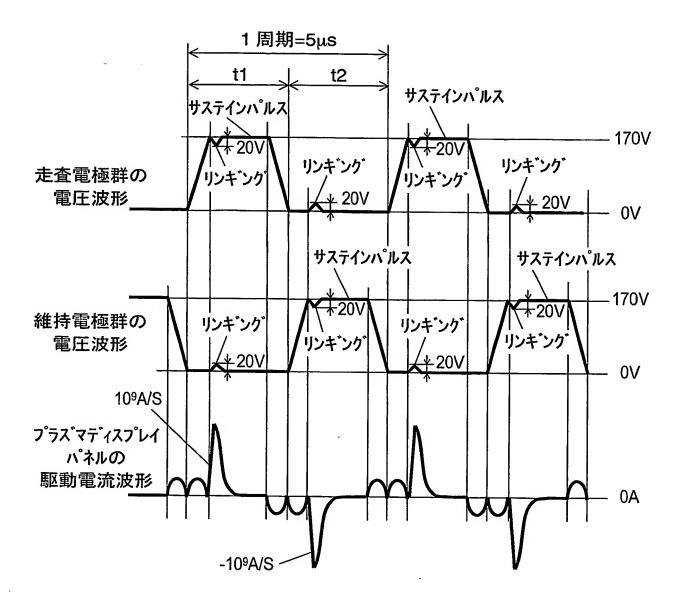
3/11

FIG. 3A

FIG. 3B



4/11 FIG. 4



^{5/11} **FIG.** 5

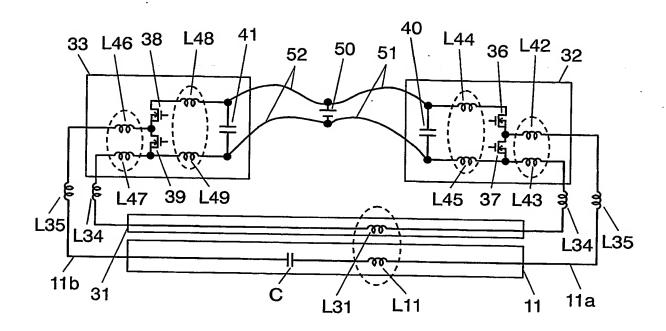
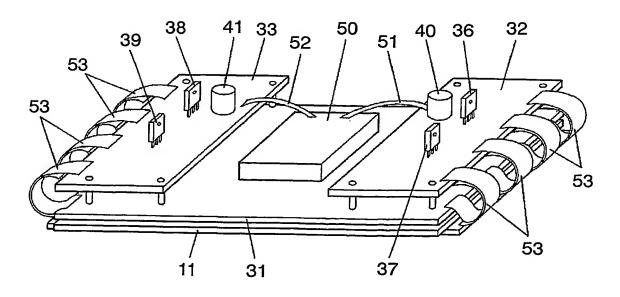
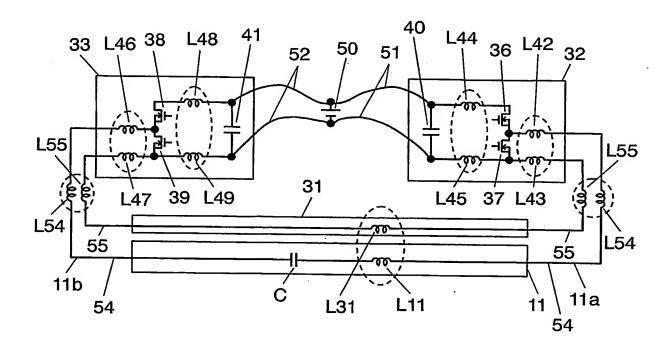


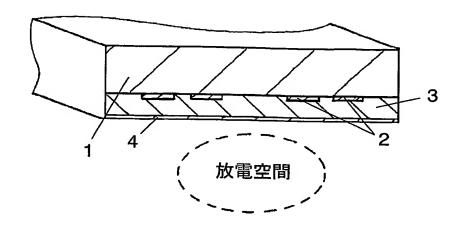
FIG. 6



6/11 FIG. 7



7/11 FIG. 8



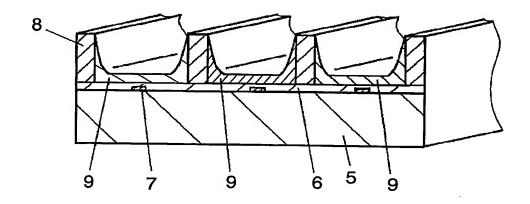
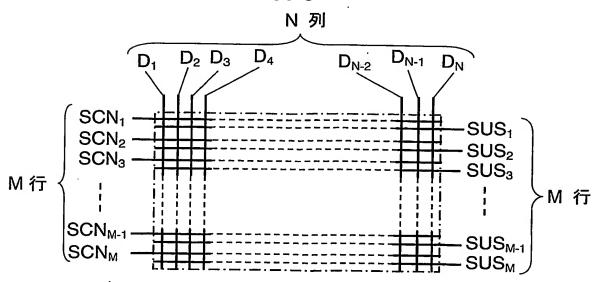
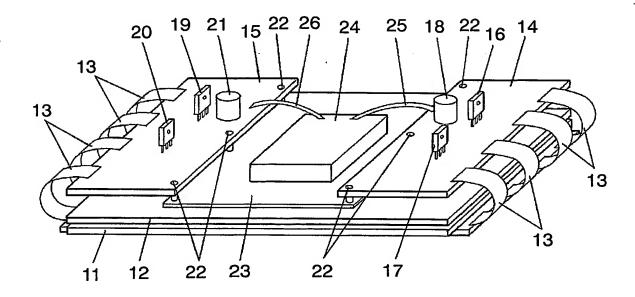


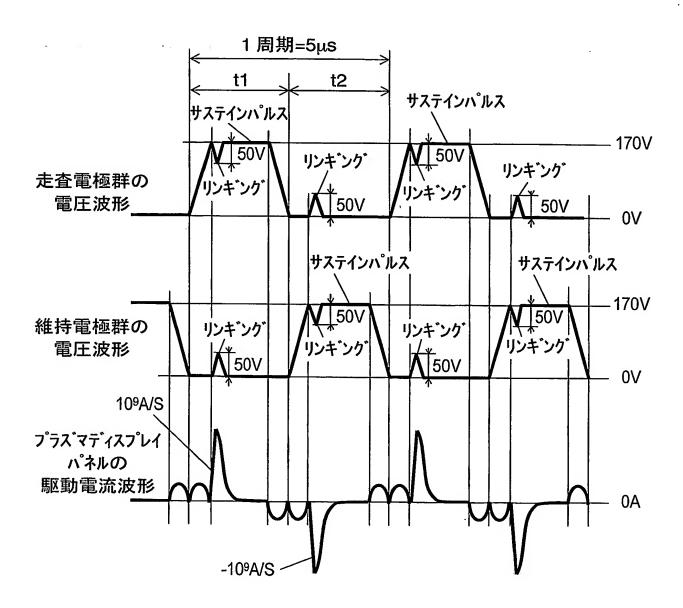
FIG. 9



8/11 FIG. 10

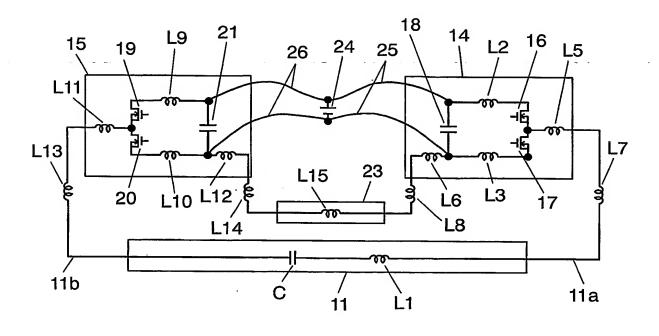


9/11 **FIG. 11**



 $\mathcal{L}_{\mathcal{A}}$

10/11 FIG. 12



11/11

図面の参照符号の一覧表

- 11 パネル
- 31 シャーシ部材
- 32、33 サステイン回路基板
- 35、53 フレキシブル接続基板
- 36、37、38、39 スイッチング素子
- 40、41 平滑コンデンサ
- 42、43、44、45、46、47、48、49 配線パターン



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/006072

	ATION OF SUBJECT MATTER	<u> </u>			
Int.Cl ⁷ G09G3/28, H01G4/12, H01L25/07					
		•			
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
B. FIELDS SEA	RCHED				
B)	entation searched (classification system followed by cla	assification symbols)			
. Int.Cl7	G09G3/28, H01G4/12, H01L25/07	1			
			•		
Dogumentation	annohad other than minimum down the				
Titemon's	earched other than minimum documentation to the exter Shinan Koho 1922–1996 Tot				
		roku Jitsuyo Shinan Koho tsuyo Shinan Toroku Koho			
					
Electronic data b	ase consulted during the international search (name of d	ata base and, where practicable, search t	erms used)		
	•				
C. DOCUMENT	IS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
			<u> </u>		
Category*	Citation of document, with indication, where app	• • •	Relevant to claim No.		
Y	JP 2001-272944 A (NEC Corp.)	,	1-5		
	05 October, 2001 (05.10.01),				
	Par. Nos. [0010], [0037], [00	86]			
	(Family: none)				
' · Y	TP 2002-261449 7 /NCV Charle				
	JP 2002-261448 A (NGK Spark 13 September, 2002 (13.09.02)	Plug Co., Lta.),	1-5		
	Par. Nos. [0023], [0041]	•			
		2002/86561 A1			
	& US 2002/159243 A1	2002/00001 A1			
Y	JP 2002-26246 A (Toshiba Cor	p.),	1-5		
	25 January, 2002 (25.01.02),				
	Par. No. [0036]				
	(Family: none)				
		•			
Further doc	uments are listed in the continuation of Box C.				
<u> </u>		See patent family annex.			
pocial calc	gories of cited documents: efining the general state of the art which is notconsidered	"T" later document published after the in	ternational filing date or priority		
. to be of part	icular relevance	date and not in conflict with the appli the principle or theory underlying the	invention		
"E" earlier appli	cation or patent but published on or after the international	"X" document of particular relevance; the	claimed invention cannot be		
filing date	hich may throw doubts on priority claim(s) or which is	considered novel or cannot be constep when the document is taken alon	idered to involve an inventive		
cited to est	ablish the publication date of another citation or other	"Y" document of particular relevance; the			
special reason	on (as specified)	considered to involve an inventive	e step when the document is		
"P" document re	ferring to an oral disclosure, use, exhibition or other means ublished prior to the international filing date but later than the	combined with one or more other suc being obvious to a person skilled in the	h documents, such combination		
priority date	claimed	"&" document member of the same patent			
			•		
Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report					
28 June, 2004 (28.06.04) 13 July, 2004 (13.07.04)					
Name and mailir	ng address of the ISA/	Authorized officer			
	se Patent Office	•			
<u></u>					
Form PCT/ISA/21	0 (second sheet) (January 2004)	Telephone No.			
III/I///	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/006072

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
Y	JP 7-326536 A (Kyocera Corp.), 12 December, 1995 (12.12.95), Par. Nos. [0008] to [0009] (Family: none)	1-5
·		
,		
ŕ		
	•	



A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類 (IPC))

Int. C1'G09G3/28, H01G4/12, H01L25/07

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl'G09G3/28, H01G4/12, H01L25/07

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2004年

日本国登録実用新案公報日本国実用新案登録公報

1994-2004年1996-2004年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

	連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
Y .	JP 2001-272944 A (日本電気株式会社) 2001.10.05、段落番号10、37、86 (ファミリー無 し)	1 — 5	
Y	JP 2002-261448 A (日本特殊陶業株式会社) 2002.09.13、段落番号23、41 & JP 2002 -246759 A & US 2002/86561 A1 & US 2002/159243 A1	1 — 5	

区欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献
国際調査を完了した日 28.06.2004 国際調査報告の発送日 13.7.2004
国際調査機関の名称及びあて先
日本国特許庁(ISA/JP)
郵便番号100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 6489



C (続き). 関連すると認められる文献			
引用文献の カテゴリー*	,	関連する調求の範囲の番号	
Y	JP 2002-26246 A (株式会社東芝) 2002.01.25、段落番号36 (ファミリー無し)	1-5	
Y	JP 7-326536 A (京セラ株式会社) 1995.12.12、段落番号8-9 (ファミリー無し)	1-5	
		,	